**國家中山科學研究院飛彈火箭研究所**

**107年第二次專案人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

107年第二次專案人力進用：研發類29員、技術類18員，共計47員(如附件1員額需求表）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：各單位依招考公告薪資總額基準表面議，惟薪資總額區分基本薪及變動薪，基本薪依公告職缺之限定學歷核給，其餘金額列入變動薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)可申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)支領退休俸之退伍軍士官再任本院員工，依「陸海空軍軍官服役條例」第32條規定及立法院決議事項(按所任職務薪資減月退休俸減優存利息之差額支給)辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(**持國外學歷者，需符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格**)

(一)研發類：

1.國內、外各大學院校理、工學院碩士畢業，其學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

2.非理工學院之特殊領域相關系所碩士(含)以上學歷畢業之特殊人才，依本院「特殊領域人才進用作業規定」(如附件4)審認。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術類：

1.高中、職(含)以上學歷畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用後本院始查知具下列限制條件者，因自始即未符合報考資格，本院得取消錄取資格，並不得提出異議︰

(一)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(二)無行為能力或限制行為能力者。

(三)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(四)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(五)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)因案被通緝或在羈押、管收中。

(七)依法停止任用者。

(八)褫奪公權尚未復權者。

(九)受監護宣告尚未撤銷者。

(十)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十一)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十二)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之懲罰者。

**肆、報名時間及方式：**

1. 簡章及職缺需求刊登於本院全球資訊網 (<http://www.ncsist.org.tw>)，公告報名至**107年06月19日止**。
2. 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw) 填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷，**各項資料請依序彙整在同一檔案(PDF檔)上傳**(報名步驟如附件5)。
3. 本所於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後，辦理書面審查(或資格審查)。
4. 報考人員經書面審查(或資格審查)合格者，本所以**電子郵件**通知參加甄試。
5. 不接受紙本報名及現場報名。
6. 若為本年度應屆畢業生或延畢生(報名甄試時尚未取得畢業證書者)，報名時請檢附學生證掃描檔供查驗。前述人員於錄取後，需於本院寄發通知日起3個月內(報到前)，繳交畢業證書掃描檔供查驗，若無法於時限內繳交或與報名時提供之資料不符者，則取消錄取資格。
7. 歡迎具身心障礙身分或原住民身分且符合報考資格者報名參加甄試，請於報名之履歷表上註記。
8. 為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件3)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。各項資料務必依序彙整於同一檔案(PDF檔)後再上傳。**

1. 履歷表：**請依照附件2格式填寫**。並請依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院得予不經預告終止契約解除聘雇。
2. 符合報考學歷之畢業證書掃描檔。
3. 報考所需之個人相關掃描檔資料(如：符合報考學歷畢業證書、工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等)，請參考簡章之員額需求表。
4. 提供工作經歷證明者，格式不限，但需由公司蓋章認可，內容需註明從事之工作內容(非職稱)及任職時間。
5. 若有繳交民營機構之工作經歷證明，需再檢附「勞保投保明細表」，未檢附者，該工作經歷不予認可。
6. 具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。
7. 具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。
8. 主管核章之申請表正本(如附件3)，僅本院同仁需繳交。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

1. 甄試日期：暫定於**107年06-07月**舉辦(實際甄試時間以甄試通知為準)。
2. 甄試地點：暫定於桃園市龍潭區中科院新新院區(實際甄試地點以甄試通知為準)。
3. 甄試方式：

(一)研發類：

1.初試：甄試科目及配分請參閱員額需求表。

2.通過初試者視需要於覆試前參加性格特質測驗。

3.覆試：口試作業。

(二)技術類：甄試科目及配分請參閱員額需求表。

1. 各項甄試作業如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理的調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
2. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號。若以電子郵件通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
3. 研發類筆試或書面審查不合格者及技術類筆試或實作不合格者，皆不通知參加口試。
4. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

1. 甄試合格標準：
2. 初試單項(書面審查/筆試/實作/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。
3. 覆試(口試)合格標準為70分(滿分100分)
4. 初、覆試總成績合格標準為70分(滿分100分)。
5. 如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。
6. 成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類總成績：總成績為口試覆試平均成績。

2.技術類總成績：總成績為各單項成績依比例計算後加總。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

2.技術類：依序以實作平均成績、筆試單一成績、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

1. 備取人數及儲備期限：
2. 招考員額5員(含)以上：備取人數以3員為限。
3. 招考員額4員(含)以下：備取人數以2員為限。
4. 備取人員儲備期限：自甄試結果奉權責長官核批次日起4個月內有效。

**捌、錄取通知：**

1. 甄試結果於甄試完成後一**個月內以電子郵件通知**。
2. 人員進用：錄取人員參加權利義務說明會後，再辦理報到作業。錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。
3. 人員錄取或遞補後，其他招考職缺之錄取或遞補皆需自動放棄。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

電子信箱：amethyst1219@ncsist.org.tw

總機：(03)4712201

聯絡人及分機：李日新副組長352229

 丁樂珍小 姐352232

 藍巧茹小 姐352026

附件1

| **國家中山科學研究院飛彈火箭研究所107年第二次專案人力進用員額需求表** |
| --- |
| **工作编號** | **職類** | **學歷需求** | **薪資****範圍** | **專長****(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求****員額** | **工作地點** | **甄試****方式** |
| **1** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 航空/機械  | 1.航空/機械等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)曾從事風洞/氣動力/熱流等相關研究經驗。(2)具氣體動力學/燃燒學等相關領域之研究經驗。 | 1.氣動力/熱流試驗之執行與數據分析。2.試驗設備相關之氣動力設計。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **2** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機/電力 | 1.電子/電機/電力等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)熟悉品質工程/量測檢驗與NI測試程式語言/具品保相關證照。(2)具電子電路整合設計與檢修能力/常用檢測儀器使用能力/元件市場尋求作業能力。(3)電力系統測試維護/佈線施工及電力電子訊號量測相關工作經驗。(4)具國家考試資格/技術士技能檢定。 | 1.執行電子、電機類檢驗與測試、測試設備/測試程序規劃與管制。2.品質管理作業規畫與管制。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **3** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械工程/航空工程等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列工作經驗者為佳(請檢附證明資料)：(1)具機構設計與工程分析相關工作經驗者。(2)熟悉SolidWorks /AutoCAD軟體相關工作經驗者。(3)具振動分析相關工作經驗者。 | 1.機構設計。2.產品抗振動與衝擊性能的設計、測試與分析。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **4** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 航空/機械  | 1.航空/機械/電機/工程科學/系統工程/土木等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.曾修習或具有下列經驗之一(請檢附證明資料)： (1)控制系統分析、設計與模擬。 (2)應用力學及流體力學。5.具有下列資格條件為佳(請檢附證明資料)： (1)具飛行控制設計、導引律設計或數位模擬經驗，並熟悉飛行力學、軌道力學。 (2)熟悉Matlab/Simulink 、C、C++與Java語言及Windows與Linux作業環境。 | 執行下列一項(含)以上工作1.飛行載具導引律設計。2.飛行載具控制律、飛行控制系統(自動駕駛儀)設計。3.全數位6自由度模擬驗證。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **5** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械/航空等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械類加工製造檢驗與品質管理工作經驗。(2)具資訊安全管理工作經驗。 | 1.精密機械零組件檢驗及相關品質統計及變異分析等品質管理工作。2.檢驗夾治具設計開發。3.檢測實驗室品質系統工作執行。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **6** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具下列開發經驗之  一：C++/C#/Java/ Linux/Visual Basic/ Matlab/LabVIEW/內嵌式程式。(2)具軟體通信與數位信號處理經驗。(3)具類比、數位電路、單晶片設計經驗。 | 1.軟體/韌體、DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。2.系統核心設計與測試、系統分析模擬。3.通訊程式、機構控制軟體開發。4.類比伺服控制器電路研製、人機操控介面程式設計。5.電子、電力、通信、系統整合、控制。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **7** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作經驗。(2)具C/C++/Java電腦語言能力，撰寫中層驅動界面程式工作經驗。(3)具軟體通信與數位信號處理工作經驗。(4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。 | 執行下列一項(含)以上工作：1.軟體/韌體、DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。2.通訊程式、人機操控介面程式或分析軟體設計。3.通信、系統整合、控制軟體開發。4.系統核心設計與測試、系統分析模擬。5.微處理器或FPGA整合電路軟硬體設計。6.測試系統整合設計。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **8** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空/自動控制 | 1.機械/航空/自動控制/電機/動機等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)熟悉Pro/E、SolidWorks 、Matlab、LabView 等軟體。(2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.伺服控制系統研發及系統工程整合。2.視任務需求，需配合出差執行裝備/系統安裝與測試等相關工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **9** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/光電/資訊工程等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具電子/電機/光電/資訊工程相關工作經驗。(2)具C語言或LabVIEW開發經驗、認證。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。 | 1.類比及數位控制電路設計、分析與驗測。2.PXI模組化測試系統研發設計。3.電控裝備故障隔離及排除。4.測試器軟體開發、崁入式系統應用開發。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **10** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.電子/電機/機械等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)熟悉機構、零組件設計及產品研發流程，曾執行相關系統整合、工程設計分析等研發專案相關工作經驗一年(含)以上。(2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(3)具國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。 | 1.執行車體之系統整合設計、結構分析、組裝測試及演訓驗證事宜。2.執行支援裝備之系統整合設計、結構分析、組裝測試及演訓驗證事宜。3.執行車體暨支援裝備之售後技術服務及後續維持相關事宜。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **11** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機電/控制 | 1.機械/航空/電機/控制/機電整合等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)熟悉自動控制、機電整合技術，曾執行相關研發專案相關工作經驗一年以上。(2)具備自動化機械開發經驗或相關證照。 | 1.金屬3D列印設備開發。2.執行各專案機電整合系統規劃與設計。3.執行生產計畫各專案機電裝備籌獲。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **12** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/材料等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)熟悉結構力學、金屬材料力學等專業，曾執行相關研發專案相關工作經驗一年以上。(2)具備傳統加工製造（如鑄造、機械加工）經驗或相關證照。 | 1.金屬3D列印設備開發。2.執行各專案關鍵零組件設計開發。3.執行生產計畫各專案機械裝備籌獲。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **13** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具備電腦輔助設計證照(2)具有一年(含)以上機械類3D電腦輔助設計經驗或PDM管理經驗(3)具Oracle DB管理經驗或虛擬伺服器Vmware實務經驗(4)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。 | 1.機械類電腦輔助設計3維圖檔資料輕量化技術應用研究與相關之計畫專案管理2.3維CAD資料庫虛擬伺服器(VMware)建置規劃與數據分析 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **14** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械、工業工程、電機相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.如具一年以上機械（機電）設計或程式撰寫或生產製程管理等經驗者為佳(請檢附證明資料)。 | 1.機電類產品生產製程(BOP)分析，及人機資源規劃。2.生產工程與管理之產製資訊大數據分析。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **15** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 航空/機械 | 1.機械/航空等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。(2)曾從事機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。(3)具備CAD/CAM製程設計經驗。(4)具備航太零組件設計與機械製造實務經驗。(5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 機械設計、加工、製造及產品製程規劃、研發、測試、分析等工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **16** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 航空/機械 | 1.機械/航空/造船等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具有機械設計、加工、製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。(2)曾從事機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。(3)具備CAD/CAM製程設計經驗。(4)具備航太零組件設計與機械製造實務經驗。(5)熟悉機械設計PRO/E 、SOLIDWORKS繪圖軟  體。(6)熟悉Matlab、LabVIEW軟體、單晶片控制技術或C/C++語言。(7)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.機械設計、加工、製造及產品製程規劃、研發、測試、分析等工作。2.伺服控制系統設計、微控制器軟硬體開發研製、人機操控介面設計。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **17** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具推進相關研發工作經歷為佳(請檢附證明資料)。 | 1.各型固體火箭發動機之設計、測試等工作。2.各型固體火箭發動機之熱流及結構分析等工作。3.系統工程規劃、介面整合等工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **18** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具備下列資格條件之一者為佳(請檢附證明資料)：(1)具機構設計或液/氣壓機械相關工作經驗。(2)具PRO/E、Solidworks等電腦輔助機械設計相關證照。(3)可茲佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.武器系統、軍民通用產品與測試裝備等機械設計。2.高壓氣體設備機械設計。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **19** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具備下列資格條件之一者為佳(請檢附證明資料)：(1)熟悉車體、裝備研發，曾執行相關系統整合、工程設計及分析、成本分析、作業研究等研發專案1年(含)以上工作經驗。(2)熟悉研發流程，曾執行相關專案管理、系統工程及製程改善等研發專案1年(含)以上工作經驗。(3)具國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。(4)可茲佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.機械設計： 組裝台、吊裝裝備及液壓測試平台等支裝設計、測試驗證。2.專案管理： 系統規劃與期程管制、關鍵設計技術評估、零件設計/製造/組測、構型管制、工程分析、風險管理。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **20** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/應用力學/造船等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之 一為佳(請檢附證明資 料)：(1)曾從事計算流體力學等相關領域之研究工作經驗。(2)具備使用 Fluent/CFX/CFDRC/STARCCM+等商業軟體經驗。(3)曾修習流體力學/計算流體力學/空氣動力學等相關課程。 | 1.載具內、外流場計算網格建立及流場數值模擬。2.載具外型設計及性能分析等相關工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **21** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/工業工程等相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之 一為佳(請檢附證明資 料)：(1)專案管理證照者。(2)1年(含)以上生產管理經驗者。(3)具機械類加工製造檢驗與品質管理工作經驗。(4)具機械藍圖識圖能力或經驗。 | 1.機械藍圖之生產評估。2.生產專案管理、現場生產運作管理、加工製程規劃。3.工業4.0相關產製現代化工作規畫及推動。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **22** | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械工桯/航空工桯/ 造船工程/應用力學等 相關理工系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之 一為佳(請檢附證明資料)：(1)具有專案管理/系統工程/生產管理相關工作經驗。(2)具備MS Office軟體(含Project)操作能力。(3)具國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照/證書。 | 1.飛彈、火箭及相關武器系統裝備的研發、生產和後勤之系統整合。2.專案計畫系統工程及計畫管理之推動與管制。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| **23** | 技術類 | 高中(職)畢業 | 30,900|37,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業，且具鉗工丙級(含)以上技術士證照，其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具機械相關內容工作1年(含)以上經驗(請檢附證明資料)。3.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械、組測、液/氣壓或維修產品相關工作經驗1年(含)以上。(2)具機械加工(車、銑等)或機具設備(起重機、堆高機、高特等)操作證照。(3)具液壓、氣壓或鉗工技術士證照。(4)具機械加工或機具設備(起重機、堆高機、高特等)操作相關證照。 | 可從事以下工作之一：1.武器系統硬品攻牙、上螺襯及組裝等。2.彈體翼翅模組組裝調校及測試驗證。3.彈體與發射系統機械模組組裝、修配及測試驗證。4.陣地部署與艦艇架控系統維護及測試。5.執行武器系統和裝備的組裝、使用、維修、保養等工作。6.機械設備、模組組裝、修配及測試。7.操作固定式起重機、堆高機、高壓氣體特定設備等機具設備。 | 3員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**鉗工(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **24** | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/電力控制/資訊等相關科系畢業。其他理工科系畢業者，需具電子電機相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：(1)具電子、電機、電力控制、電路板檢測或儀錶相關工作經驗1年(含)以上。(2)具室內配線或電路板錫焊工作經驗1年(含)以上。(3)具丙級以上電機電子類技術士證照。 (4)可資佐證符合專長(技能)或工作內容請求之公、民營機構訓練證照或證明。(5)具備MS Office軟體操作能力。(6)具物料管理工作經驗。 | 可從事下列工作之一：1.儀電模組製作、線路配接、機台操作與維護工作。2.電路製作、接頭接線製作 、佈線施工組裝及電路板訊號檢修。3.裝備操作、訊號模擬與量測、電子設備檢修。4.電路焊接、組裝、測試。5.BOM表建立及料件管理。6.協助演習出差相關工作。7.執行線束佈線施工及訊號量測、接頭與電子電路製作。8.執行各類型測試器測試維護、線束測試、線束佈線施工及訊號量測。9.執行各項任務裝備系統安裝、測試等相關工作。 | 3員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**錫焊實作範圍：1.依電路圖按圖施工2.電子零件腳位與極性辨識3.電烙鐵…等基本工具的使用能力4.儀表的操作5.應試者需自備鉗子、電烙鐵、焊錫、數位電表…等工具6.電源供應器與示波器由考試單位準備(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **25** | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業; 其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.對機械檢驗相關工作有興趣。3.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械類加工製造檢驗、機械識圖與品質管制/檢驗工作經驗或技術士技能檢定相關證照。(2)具三次元量床操作及程式撰寫經驗。 | 可從事下列工作之一：1.精密機械零組件檢驗、機械性能等檢驗及品質管制工作。 2.執行機械零扣件進料檢驗。 | 2員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**機械視圖與品質管理參考書籍:1.品質管制(中興管理顧問公司發行劉振譯)或一般品質管制書籍2.幾何尺寸與公差(中央圖書出版社 許兆年、詹安仁、 林榮慶編譯)3.抽樣檢驗(中華民國品質學會張有成編著)或其它抽樣檢驗書籍(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **26** | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 機械 | 1.機械/航空/土木/測繪(量)/物理/數學等理工相關科系畢業。2.對機械檢驗、空間/大地量測、物性量測相關工作有興趣。3.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：(1)具接觸式尺碼檢驗或三次元量床操作/程式撰寫經驗。(2)具空間/大地測量或物性量測工作經驗。(3)具光學/電子經緯儀/雷射追蹤儀或其他類似空間量測儀器操作能力與經驗。(4)具機械設計/(電腦輔助)機械製圖/品質管制(理)/品質檢驗等工作經驗或相關技術士技能檢定證照。 | 可從事下列工作之一：1.機械零組件檢驗及品質管制工作。2.使用經緯儀/雷射追蹤儀或其他類似空間量測儀器執行空間/大地/航空器/船舶/設施工程測量工作。3.使用重量量測機具與慣性儀等儀器執行物性量測工作。4.具機械設計與繪圖能力，可設計檢測夾治具。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**量測儀具操作實作範圍：1. 接觸式尺碼檢驗機儀具操作
2. 空間量測儀器架設與水平調整
3. 空間中兩點準直與正確讀值
4. 電子磅秤與慣性儀操作，完成指定物件重量、重心及慣性矩量測

(實作所需使用儀器均由考試單位準備，70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **27** | 技術類 | 高中(職)畢業 | 30,900|37,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業。2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：(1)具操作銑床加工經驗(請檢附工作證明或公立職訓中心上課證明)。(2)具備製程規劃與藍圖視圖能力。(3)CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照。 | 可從事下列工作之一：1.武器系統各機械零組件銑床加工等相關工作。2.CNC銑床加工程式撰寫等相關工作。 | 4員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**銑工實作範圍：NC銑床加工(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **28** | 技術類 | 高中(職)畢業 | 30,900|37,000 | 機械 | 1.機械/鈑金/冷作等相關科系畢業。2.具鈑金/冷作相關丙級(含)以上技術證照(請檢附證明資料)。3.具鈑金或冷作工作2年(含)以上經驗為佳 (請檢附證明資料)。 | 1.鈑金折彎、旋壓及捲製成型工作。2.各種材料捲管、修配與整型工作。3.電控系統箱櫃、車廂製作、修改與組裝工作。 | 2員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**鈑金或冷作實作範圍：鈑金展開技術(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **29** | 技術類 | 高中(職)畢業 | 30,900|37,000 | 機械 | 1.機械/材料等相關科系畢業；其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具熱處理工作經驗1年(含)以上為佳(請檢附證明資料)。  | 1.碳鋼或鉻鉬鋼氣氛熱處理。2.鋁合金與不銹鋼固溶、時效熱處理。3.鈦合金與鎳基合金等真空熱處理。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**材料試驗實作範圍：材料熱處理程序及硬度測試(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **30** | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/自動控制/ 電信/光電等相關科系畢業。2.檢附大學各學年成績 單(未檢附者，視同資格不符)。3.具有下列資格條件之 一為佳(請檢附證明資 料)：(1)國家考試、技能檢定等相關證照。 (2)參加國、內外競賽獲獎證明。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。(4)電子/電機相關工作經歷證明。 | 1.執行架控電力系統測試維護、載具線束測試、線束佈線施工及電力訊號量測、電子電路製作。2.執行各演訓任務裝備系統安裝、通聯測試等相關工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**實作範圍：線束接頭製作及量測(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| **31** | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電子/電機 | 1. 電子/電機/電力等相關科系畢業。
2. 具有電子/電機/電力丙級技術士相關證照。
3. 具電子/電機/電力相關工作經驗一年以上者為佳(請檢附證明資料)。
 | 1.電子電路設計製作測試與故障診斷、具基礎 程式開發能力。2.工具機及工廠輔機故障診斷與維修。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作/筆試60%：****1.實作：**電子電路配置製作。**2.筆試:** 基本電學、電路學(自動控制系統第9版,鼎茂圖書,張碩、詹森 合著)。【屆時採筆試或實作，或二者併行】(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 合計：研發類29員、技術類18員，共計47員。 |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 |  | ★身分證號碼 |  | 最近三個月1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | 年月日 | 婚姻 | □已婚 □未婚 |
| ★兵役狀況 | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) |
| ★電子郵件 |  |
| ★通訊處 | 戶籍地址 |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | 連絡電話 |  |
| 居住國外在台聯絡人員(緊急聯絡人) |  | 行動電話 |  | 連絡電話 |  |
| ★學歷 | 學校名稱 | 院系科別 | 學位 | 起迄時間 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 |
| ★經歷 | 服務機關名稱 | 職稱(工作內容) | 起迄時間 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 家庭狀況★ | 稱謂 | 姓名  | 職業 | 服務機關 | 連絡(行動)電話 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** |
| 親屬及朋友在中科院任職之★ | 關係(稱謂) | 姓名  | 單位 | 職稱 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | 體重：　　 　　　公斤 | 血型： 　　　型 |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | 族 別：　　　 　　　　　族 |
| 身心障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) |

**履　　　　　歷　　　　　表**

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 簡要自述(請以1頁說明) |
|  |

(本表若不敷使用請自行延伸)　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修，如未檢附者，視同資格不符**

1. 畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

1. 學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

1. 學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

1. 英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

1. 具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

1. 相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

1. 其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現職單位（至二級） | 姓名(身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷(含科/系/所) |
|  |  |  |  |
| 擬參加甄選單位職缺 |
| 報考單位(或工作編號) | 職類 | 職缺 |
|  |  |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | 一級單位主管批示 |
| 電話： |  |  |
| 一級人事單位 |
|  |

備註：非本院現職員工免填。

附件4

國家中山科學研究院特殊領域人才進用作業規定

一、特殊進用適用對象

非理工科系之特殊領域相關科系碩士(含)以上學歷：大學及碩士修滿與特殊領域相關課程24學分且具備特殊領域證照、競賽得名或特殊技能者，得報名參加本院公開招考。

二、相關專業證照、競賽性質、特殊技能等採計條件如附表

附表-特殊領域限制條件採計表

| 特殊領域 | 限制條件 | 內容 | 採計審認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資訊安全 | 資訊管理或應用相關科系碩士(含)以上學歷 | 大學及碩士須修滿與資訊學科相關課程24學分。 | 相關證照、競賽性質、資安技能認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所及資訊管理中心共同成立審查小組審認之。 |
| 資安國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)ISO 27001之資訊安全管理系統主導稽核員認證(2)ECSA 資安分析專家認證(3)EDRP 資安災害復原專家認證(4)CCISO 資安長/EISM資安經理人認證(5)CISSP 資訊安全系統專家認證(6)CSSLP 資訊安全軟體開發專家認證(7)CCIE Security 認證(8)RHCA Red Hat Linux系統安全調校認證(9)LPT 滲透測試專家認證(10)Guidance EnCase 國際專業鑑識認證(11)CHFI 資安鑑識調查專家(數位鑑識) |
| 國際重要資安競賽(本項適用對象須具備右列2年內國際資安競賽獲得前10名(含)至少一項) | (1)Defcon CTF Qualifier(2)Plaid CTF(3)Boston Key Party CTF (BKPCTF)(4)HITCON CTF(5)Hack.lu CTF(6)RuCTFe |
| 資安特殊技能 | (1)對資訊安全領域有重要成就或傑出表現(如挖掘重要資訊系統弱點，經正常管道提報，避免重大損害)。(2)曾於Defcon、BlackHat國際重大論壇發表論著。(3)曾挖掘零時差弱點於HITCON ZERODAY或Vulreport經審認發表。 |
| 軟體開發與管理 | 軟體開發與管理相關國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)OCM：Oracle Certified Master(2)Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)(3)Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)(4)Red Hat Certified Engineer(RHCE)(5)Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop(CCAH)(6)Cloudera Certified Professional (CCP Data Engineer)(7)Certified Software Quality Engineer(CSQE)(8)Certified Software Testing Engineer(CSTE)(9)ERP軟體顧問師(ERP Software Consultant)(10)進階ERP規劃師(Advanced ERP Planner)(11)ERP導入顧問師(ERP Implementation Consultant)(12)OMG Certified UML Professional (OCUP) Advanced(13)Certified CMMI for Development Supplement Instructor(14)Certified CMMI Professional(15)BI 企業顧問師(BI Enterprise Consultant)(16)BI 軟體顧問師(BI Software Consultant)(17)BI企業績效管理顧問師(BI performance Management Consultant) | 相關證照認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所或資訊管理中心成立審查小組審認之。 |

三、一般事項

(一)相關證照、競賽性質、特殊技能認定及科技技術年資採計，有疑義由提出之專業單位成立審查小組審認。

(二)如特殊領域牽涉範圍超出單一專業，則有疑義由提出之專業單位主辦，召集相關單位共同成立審查小組審認。

附件5

**本院網路徵才系統報名步驟**

|  |
| --- |
| 人才招募系統操作1060809_頁面_1 |
| 人才招募系統操作1060809_頁面_2 |
| 人才招募系統操作1060809_頁面_3 |